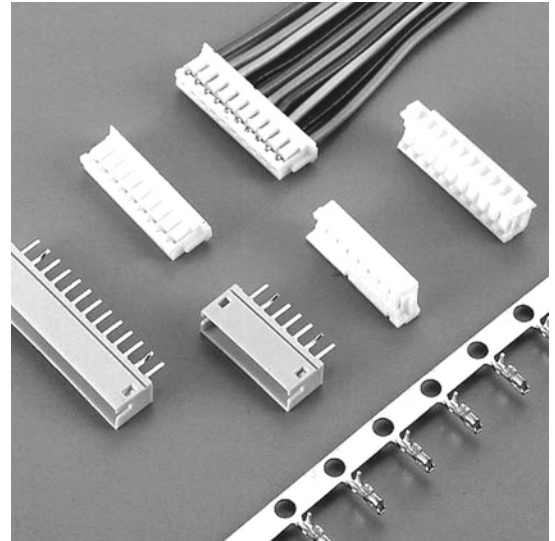


Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,50mm, gerade, 1-reihig Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.50mm Pitch, Straight, Single Row

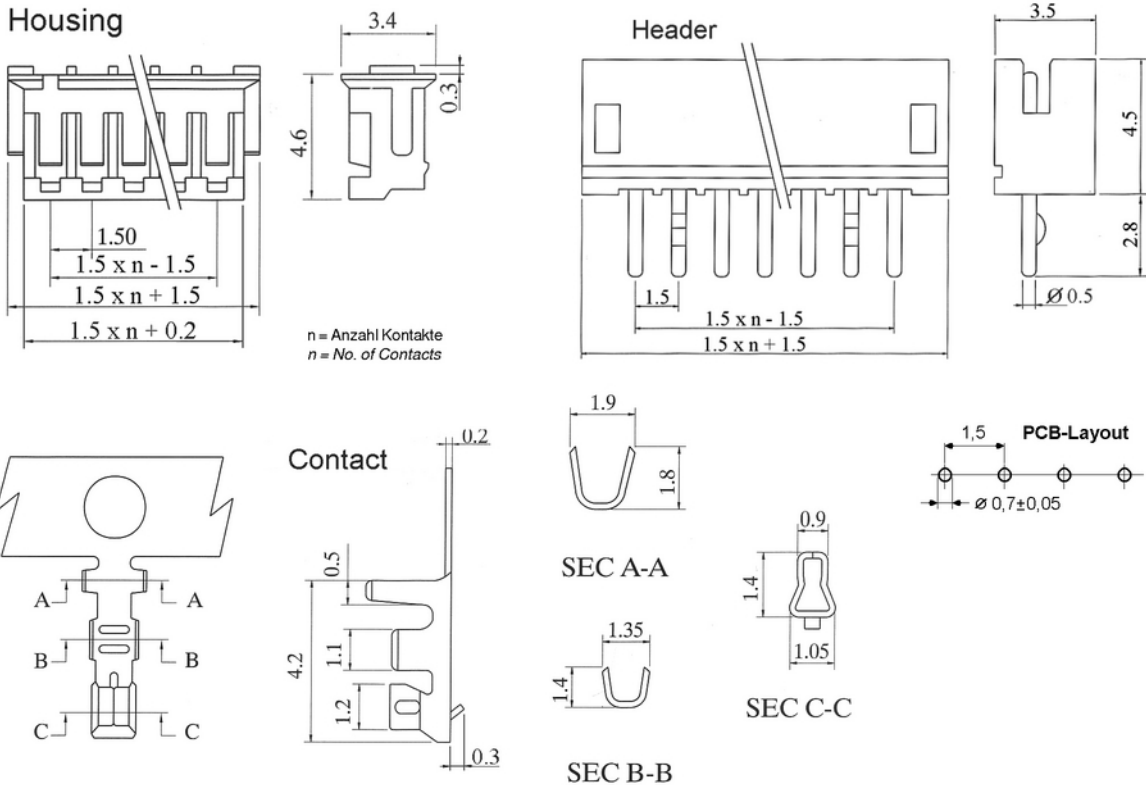
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ... 32
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25°C ... +85°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende SMT-Stiftleisten:
Mate with SMT-Pin Header Series:
5690



Series	Contacts*	Type*	Plating
569	13 02-13	3 1 Buchsengehäuse <i>Housing</i> 2 Buchsenkontakte <i>Crimp contacts</i> 3 Stiftleiste gerade <i>Straight pin header</i>	50 50 Verzinkt (bei Gehäusen nicht erforderlich) <i>Tin plated (not necessary for housings)</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

